公司代码：688125　　　　公司简称：安达智能

广东安达智能装备股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分的内容，请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本及其他形式的利润分配。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用　√不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	安达智能	688125	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨明辉	叶慧
联系地址	广东省东莞市寮步镇向西东区路17号	广东省东莞市寮步镇向西东区路17号
电话	0755-86544020	0755-86544020
传真	0769-83373692	0769-83373692
电子信箱	anda-ir@anda-dg.com	anda-ir@anda-dg.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主要从事流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备、ADA智能平台、半导体装备等智能制造设备及系统平台的研发、生产和销售，产品可广泛运用于消费电子、汽车电子、AI服务器、新能源、半导体、智能家居、医疗等多领域电子产品的智能生产制造，致力为客户提供工厂智能制造整体解决方案。

历经多年发展和技术积累，公司已形成核心零部件研发、运动算法和整机结构设计的一体化技术平台，依托一体化技术平台，公司的智能制造装备已在技术水平、生产效率和交付速度等方面具备较强的竞争优势，已与全球科技行业头部客户及产业链EMS客户建立了长期、稳定、深度的合作关系，帮助其在点胶、涂覆、等离子清洗和组装等多个环节实现自动化、智能化和柔性化生产。

2、主要产品

公司产品主要包括点胶机、涂覆机、涂覆AOI检测设备、灌胶机、等离子清洗机、固化炉、智能组装设备、ADA智能平台、五轴联动数控机床、超快激光设备、仓储物流设备等多种智能制造装备和点胶阀体、驱控、电机等多种核心零部件，是电子信息制造业实现自动化、智能化和高效化生产的关键核心装备，目前已形成了以高端流体控制设备为核心、覆盖多道工序的多元化产品布局。

（1）流体控制设备

流体控制设备主要包括点胶机、涂覆机、灌胶机和喷墨机等。流体控制设备可广泛应用于消费电子、汽车电子、新能源、智能家居和半导体等领域产品的SMT电子装联段、FATP后段组装的底部填充、围坝、引脚封装、堆栈封装POP、补强、三防涂覆等工艺，以实现电子产品的贴装和部件组装。

产品类别	产品系列	典型产品图示	产品性能
点胶机	AD系列（在线）	AD-16系列智能精密点胶机	1.用途：用于消费电子产品、半导体产品等SMT段点红胶、底部填充、零件包覆、IC补强、IC点围坝胶、封装点胶等工艺。2.产品特点：XY轴采用直线电机，运动精度更高；集成CCD视觉系统，可分配胶量、抓拍轨迹、扫描条码；可选配双阀同步点胶（任意选配喷射式点胶阀、螺杆阀、切割阀等）。
点胶机	iJet系列（在线）	iJet-7M/7H/7L系列高速点胶机	1.用途：适用于3C、汽车电子、MiniLED等行业电气元器件底部填充、引脚包边、表面贴装点胶等工艺。2.产品特点：压电式喷射阀点胶；可适用小、中、大尺寸PCB板/MiniLED板点胶；可根据工艺需求选配单轨单阀&双轨双阀或单轨双阀结构，阀间距自动调节30-60mm；可实现四方位倾斜；可选配增压泵、激光测高系统等。
		iJet-9/9L/9P系列智能精密点胶机	1.用途：适用于LED、新能源等大尺寸产品专用点胶机，包括引脚包封、表面贴装、补强、FPC元器件（连接器、镍片、NTC等）点胶。2.产品特点：单阀X轴点胶行程可达860mm；可进行双板同时点胶；整机模块化设计，灵活可升级；可实现四方位倾斜；搭配CCD视觉系统，实时监测点胶精度和一致性。
		iJet-S10/S11系列智能精密点胶机	1.用途：适用于3C、半导体封装等精密行业点胶应用工艺（包括芯片底部填充、点助焊剂、锡膏、IGBT封装、补强等）。2.产品特点：压电式喷射阀点胶；可选拓展工艺模块丰富，满足客户不同点胶工艺需求；可根据工艺需求选配单轨&双轨&双阀结构，
	离线式点胶系列	TSV-200D/300系列桌面点胶机	1.用途：热熔胶粘接、底部填充、引脚包封、堆栈封装POP、围坝与填充、点红胶、FPC元器件补强等。2.产品特点：设备为离线式点胶设备、桌面点胶设备，占地空间较小，采用线性模组+伺服电机驱动。
	ADG系列（在线）	ADG-5DI五轴高速点胶机	1.用途：热熔胶粘接、底部填充、引脚包封、堆栈封装POP、围坝与填充、点红胶、FPC元器件补强等。2.产品特点：（1）采用直线电机+运动控制卡；（2）使用五轴联动控制技术，可实现产品空间任意点胶轨迹需求；（3）可直接导入任何品牌的贴片机文件，也可在线视觉编程；（4）可选配激光高度检测系统，工件变形后可自动校准Z轴高度；（5）可选配称重测重系统，智能控制及检测点胶量，确保点胶的一致性。
		iCoat-3精密涂覆机	1.用途：适用于多行业涂覆应用，可进行多拼版的涂覆，进行制程工艺多样的大面积选择性涂覆工艺。系统，智能控制及检测点胶量，确保点胶的一致性。
		iCoat-3精密涂覆机	1.用途：适用于多行业涂覆应用，可进行多拼版的涂覆，进行制程工艺多样的大面积选择性涂覆工艺。2.产品特点：可进行多方位多角度喷涂，解决高精度零件死角喷涂问题；伺服电机搭配进口模组组成传动装置，稳定性好。
		iCoat-6精密涂覆机	1.用途：薄膜阀专用设备，用于喷涂边界清晰无锯齿无飞溅的高精度喷涂工艺。2.产品特点：专用的无气压供料系统搭配流体的自动加热过滤循环系统，保证流体粘度，减少气泡产生。
灌胶机	真空灌胶/常压灌胶机		1.用途：适用于消费电子、新能源、汽车电子等行业功能模块SMT段/装配段的注胶、灌胶工艺，用于电机、变压器、控制板等密封及固定。2.产品特点：适用于高填料的胶水，可实现毫克级别精度灌胶，适合单组分、双组份以及多组分灌胶工艺。
喷墨打印机	智能单/彩色喷墨打印机		1.用途：替代传统丝印、移印、套印、贴标签、印刷、涂覆、点胶等工艺。2.产品特点：兼容单通道打印和多通道叠印，支持彩色打印，支持自动调色功能，RIP算法完全自主开发，并能实现在线实时可变打印；可根据客户的个性化需求特别定制供应；整个软件控制系统完全自主开发。
	在线视觉引导喷墨打印机		1.用途：替代传统丝印、移印、套印、贴标签、印刷、涂覆、点胶等工艺。更容易嵌入客户自动化生产线，适应客户更多复杂的应用场景。2.产品特点：在线连续视觉飞拍引导打印，产品可无序摆放皆可完美打印在产品的指定位置，可选打印后在线连续飞拍AOI打印质量检查，可选在线跟踪OK/NG分拣；整个软件控制系统完全自主研发。
	iPJet-7数字化喷涂机		1.用途：应用于PCBA等电子产品的封装保护领域，是将UV胶水精准的喷射至需要防护的区域，并通过多层堆叠形成3D形态，为PCBA、FPC等产品提供高强度的保护。2.产品特点：（1）创新的数字化封装工艺流程；（2）高精度：打印精度0.1mm；（3）喷头组件模块化，可针对墨水/胶水搭载不同类型的喷头组件模块进行快速更换；（4）智能维护打印头：可选墨滴观测仪功能，机器视觉判定堵孔状况，自动保湿清洗，自动维护喷头；（5）搭载水冷UV固化灯，打印后即刻固化，作业效率高；（6）可导入Gerber,CAD,PDF,图片,STL 3D模型,PLY 3D模型，或在线视觉引导3D建模，生成涂覆位置信息或进行3D打印。

（2）等离子设备

等离子设备主要有真空等离子清洗机和常压等离子清洗机，用于清洗FPC、PCB、半导体引线支架、玻璃和各种手机零部件等表面有机物，以提高产品表面附着力，从而提升产品可靠度。

产品系列	典型产品图示	产品性能
VP系列	VP-10L在线式真空等离子清洗机	1.用途：清洗FPC、PCB、玻璃和手机零部件等表面有机物、去静电，提高表面附着力。2.产品特点：真空腔体采用铝合金制成，抽真空时间≤15秒，破真空时间≤5秒；输送机构采用电动调幅，宽窄可任意调节；可实现超低温清洗，温度最低至40度；异向等离子体可以进入超细狭缝来实现全方位清洗。
	VP-60L/80L系列全自动离线式等离子清洗机	1.用途：清洗FPC、PCB、玻璃和手机零部件等表面有机物、去静电，提高表面附着力。2.产品特点：真空腔体采用不锈钢制成，抽真空时间≤55-70秒，破真空时间≤15-20秒；可实现超低温清洗，温度最低至40度；异向等离子体可以进入超细狭缝来实现全方位清洗。
	VP-10S离线真空等离子清洗机	1.用途：半导体基板及引线框架的清洗。去除表面有机物，提高表面附着力。2.产品特点：同时可进4块产品，双下电极交替运行，更高工作效率，UPH可达400-500，抽真空时间≤15秒，破真空时间＜5秒；卡料报警保护，真空、射频超值报警，符合SEMI要求。
AP系列	AP-7/3P等离子清洗机	1.用途：对产品表面要求不高的FPC、PCB、手机零部件等表面有机物进行清洗，提高表面附着力。2.产品特点：清洗速度快、适用广，采用直线电机驱动或伺服+丝杆驱动；相较真空等离子清洗机而言，供气类型更加多样，可选压缩空气或氮气；使用成本低。

（3）固化、智能组装设备及其他设备

固化设备包括红外固化炉、紫外固化炉和热风固化炉，主要用于产品完成点胶或涂覆、灌胶或打印等工序后的固化或烘干。智能组装设备主要用于零部件或产品贴装、插装、锁付等工序，包括上料机、下料机和传输设备等其他设备。

ADA智能平台是在通用机架的基础上搭载主机模组形成一个通用平台，再在通用平台基础上搭载不同的工艺模块、供料模块、输送和校准模块以快速形成一台智能平台设备，实现给什么工具和物料就能完成相应的工序工作，如点胶、涂覆、组装、等离子清洗、锁付、视觉检测等。ADA智能平台的"智能"体现在设备具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应的特点，能有效解决制造业设备不通用、故障排除时间长、操作技术门槛高、换线转产不灵活的行业四大痛点问题。

产品类别	产品系列	典型产品图示	产品性能
固化设备	红外固化	iCure-2/3/4系列红外固化炉	1.用途：用于热固胶水涂覆后的固化。2.产品特点：双层炉腔设计，隔热效果更佳；可拆卸式温区，维护更便捷；温度精度可控制在±5°C；多段式独立控温，PID调节，节能高效。
	紫外固化	UV-1/2/3系列固化炉	1.用途：UV胶水涂覆、点胶后的固化。2.产品特点：自制光源及先进变频电源技术，有效保证紫外能力稳定输出，大幅降低能耗；多样性光源组合，汞灯、无极灯管/LED、UV灯等可满足多种固化方式。
	热风固化	VCO系列热风固化炉	1.用途：手机背板及盖板（CG与BG）喷墨后的预固化。2.产品特点：每个模块采用电阻丝加热，高温马达及风轮运风，配有加热箱及整流板；采用立式固化设计，极大节省空间。
及其他	ADA智能平台H系列		1.用途：多工艺模块化的平台型通用设备。2.产品特点：整个主机模组独立控制，可快速拔插，实现工艺切换，并与MES系统连接；所有工艺模块都带有嵌入式微电脑+Linux系统，可实现软件自控与参数存储；所有工艺模块都有唯一的IP地址，快速对接上位机后能自动识别，自动运行相关软件及程序。
	周边组装设备	自动接驳台/上下料机；升降机/自动翻板机/检测台	1.用途：用于SMT涂覆生产线、点胶生产线及定制化生产线中各设备之间的连接，完成生产线前后端的自动上料与收料，完成货物的升降、运输、分拣等工作，也可用于PCB板之缓冲、监测的过渡阶段。2.产品特点：采用整体钣金焊接机架，减少设备晃动，减少胶体流动；过板宽度可根据实际需要在50-460mm范围内任意调节；控制方式采用PLC+触摸屏控制、按钮+控制板控制。
	测试烧录分选机	芯片测试烧录分选机	1.用途：应用于表面贴装半导体器件生产后的工序，能完成器件的电参数设置、分类甄选储存、激光打印标识、标识检测、外形尺寸检测。2.产品特点：转盘式16工位设计；可选配盘装/编带/振动盘上下料模式；可配AOI、激光打标等多种功能。
	激光器	Icefire深紫外飞秒放大器	1.用途：用于单晶硅、多晶硅、碳化硅、氮化镓等半导体晶圆微纳加工和物性检测，表面改性等工艺。与终端深紫外激发、加工、光刻系统高度适配。2.产品特点：激光器系统整机一体化集成，可切换至近红外800nm、紫外400nm、深紫外266nm三个波段的飞秒激光，能量高达7mJ，重频可在1Hz-1kHz调节，脉冲宽度具有100fs以下的时间特性，无热影响区，满足精度1μm以内的激光刻写加工。
	激光器	Icefire-Pico三波长皮秒激光器	1.用途：用于晶圆裂片划片、物性检测、激光剥离、OLED面板加工、碳纤维结构件等复合材料切割，适用于三波长复杂加工场景。2.产品特点：三波长一体化集成，可同时输出近红外1064nm、绿光532nm、深紫外266nm三个波段的皮秒激光，激光功率130W，深紫外高达10W，重频可在10Hz-54MHz调节，脉冲宽度5ps以下，具备脉冲串控制功能。2.产品特点：三波长一体化集成，可同时
	五轴联动数控机床		2.产品特点：具有高效率、智能化、物联网、紧凑型、高精度和高加速度等诸多优势性能；采用高刚性恒温结构、全冷却传动系统，能有效提高机床整体稳定性和加工精度稳定性；配置20,000rpm高刚性主轴；内置10kg六关节机器人及智能仓库，能实现单机无人化作业。
	仓储物流设备	SMT智能电子库	1.用途：用于SMT行业多种电子元器件的自动存储和自动配料（盘装料、Tray盘均可兼容）。SMT智能电子库实现智能化、无人化运作，物料从仓库到产线的存、拣、配、查、出，等系列流转动作，实现电子物料"一物、一码、一库位"精准管理。2.产品特点：先进先出，尾料优先，实现对物料的精确管理；兼容4种规格托盘，支持7英寸、11英寸、13英寸盘装料及Tray盘；高密度双深存储；二维码及视觉轮廓识别，防呆防错，准确率高；采用唯一码，物料具有可追溯性；智能高效运作，减少人为失误；可视化存储空间，库位信息实时显示。
	仓储物流设备	AD-PTL智能亮灯拣选料架	1.用途：通过高效率、高准确性的亮灯拣选的软硬件系统，实现从SMT智能电子库到SMT产线的全流程物料管控，对料架上的每一个储位物料进行实时感应监控，对非控制的入库、取料、挪料动作报警提示。2.产品特点：具备防呆防错功能，防止由（依据生产工单，多系统数据联动）协同作业，通过共享信息、协调行动、相互配合，共同完成工作目标；信息追溯，确保信息的透明度、可验证性，有效、准确地关联其所有相关信息；便捷易用，易于理解、操作简单、流程顺畅、省时省力。
	仓储物流设备	AD-L300潜伏顶升机器人（AMR）	1.用途：通过潜伏到料架底部，利用升降机构提升料架，实现物料的输送；多用于物料架、物料车的转运，有效降低人力资源成本，减轻人工劳动强度。2.产品特点：激光SLAM导航+二维码导航；支持整个料架搬运，提高单次物料搬运量；免维护电池，智能电量管理，自主充电；高效自动化运行，精准定位，自主导航避障。
	仓储物流设备	AD-DL200滚筒升降机器人	1.用途：是通过滚筒与工位物料对接完成物料输送、运输，利用升降机构提升滚筒面高度，实现多种高度工位对接；多用于不同工位物料的转运，有效降低人力资源成本，减轻人工劳动强度。2.产品特点：激光SLAM导航+二维码导航；精准定位，自动上下料；对接高度范围380~530mm；免维护电池，智能电量管理，自主充电；自主导航避障
	仓储物流设备	AD-L300-C智能通用充电桩	1.用途：智能充电桩是专为AMR设计的自动化充电设备，通过智能调度和能源管理技术，实现AMR在无人干预情况下的自主充电。2.产品特点：安全性高，具有短路、过压、过流、过温、反接保护等安全保护能力。通用设计，适应不同机器人需求。直观的灯光显示和便捷的屏幕交互。可适配电池，自主调整充电电流。具有手动和自动充电两种模式。
及其他	氢能源设备	片材式狭缝挤压涂布机	1.用途：用于燃料电池阴阳极催化层的涂布。2.产品特点：采用微孔型涂布平板，配置精密真空压力调节，有效保证涂布质量且防止质子交换膜溶胀；供料系统与涂布模头一体化设计，有效减少浆料在管道内残余；模头定位采用闭环控制，定位精度±1μm
	氢能源设备	平板热压机	1.用途：用于催化层的热转印及5-MEA的热压补强。2.产品特点：采用力的全闭环控制控制模式，带有独特的PID自整定功能，确保压合力的稳定性；采用高精度压力传感器，可实现全量程有效测量
	氢能源设备	精密裁切机	1.用途：用于边框膜、CCM、质子交换膜、GDL、5-MEA等膜材料的裁切。2.产品特点：可实现全切或者半切；可CAD图形路径导入实现裁切
	氢能源设备	片材式五合一贴合机	1.用途：用于5-MEA制备。即边框膜与CCM的贴合。2.产品特点：采用网箱贴合，贴合稳定，无气泡；采用高精度CCD对位，配合UVW纠正平台，产品尺寸兼容性强；具备加热功能，兼容压敏胶及热熔胶边框膜的贴合
	氢能源设备	片材七合一贴合机	1.用途：用于7-MEA制备，及GDL与5-MEA的贴合。2.产品特点：采用高精度CCD对位，配合UVW纠正平台，产品尺寸兼容性强；点胶平台具备加热功能；设备采用压电陶瓷喷射阀对GDL进行点胶，兼容压敏胶和热熔胶；设备具备自动擦胶，排胶功能。
	氢能源设备	气密检测设备	1.用途：用于MEA的气密性检测。2.产品特点：兼容流量法和压差法；特制密封圈，防止对MEA造成伤害
			1.用途：用于燃料电池阴阳极催化层的涂密封圈，防止对MEA造成伤害
	氢能源设备	催化层涂布机	1.用途：用于燃料电池阴阳极催化层的涂布。2.产品特点：采用全套伺服电机总线控制，确保走带速度更加稳定；采用精密电驱阀配合涂布模头高响应位移，有效改善涂层头尾异常区；模头定位采用闭环控制，定位精度±1μm；可选配在线厚度检测、尺寸检测、瑕疵检测。
	涂覆AOI检测设备	ACI-S4700大视野涂覆AOI	1.用途：在产线生产流程中，为了提升三防涂覆的质量，对UV涂覆结果进行检测。2.产品特点：100%自主产权的软件开发，包括定位、条码识别、提取区域、缺陷检测；基于OpenCV的定位技术，三步完成设置,操作简单；创新采用大模型SAM视觉领域最新技术，可无视轨道或产品的位置偏差，区域识别更精准；"0"代码交互平台，无需编码，更高效/稳定/易用。
		ACI-F500双面飞拍涂覆AOI	1.用途：在产线生产流程中，为了提升三防涂覆的质量，对UV涂覆结果进行检测。2.产品特点：AI驱动的飞拍识别技术，成像清晰且效率提升50%。高精度（像素精度21um）。100%自主产权的软件开发，包括定位、条码识别、提取区域、缺陷检测；基于OpenCV的定位技术，三步完成设置,操作简单；创新采用大模型SAM视觉领域最新技术，可无视轨道或产品的位置偏差，区域识别更精准；"0"代码交互平台，无需编码，更高效/稳定/易用。
		ACI-F1200双面飞拍涂覆AOI	精度15um），面向元器件高度/连接器涂覆效果。100%自主产权的软件开发，包括定位、条码识别、提取区域、缺陷检测；基于OpenCV的定位技术，三步完成设置,操作简单；创新采用大模型SAM视觉领域最新技术，可无视轨道或产品的位置偏差，区域识别更精准；"0"代码交互平台，无需编码，更高效/稳定/易用。

（4）配件及技术服务

公司销售的配件以阀体为主，包括点胶阀、涂覆阀、雾化阀、薄膜阀等，用于消费电子、汽车电子、LED、新能源等多领域的表面贴装胶、导电银浆、IC封装胶、底部填充胶、涂助焊剂或活化剂等工序环节。技术服务业务是公司为保障客户生产线的稳定、安全、高效运行而提供的运营维护服务，具体内容包括智能制造装备的操作培训、定期检查、维护保养、故障分析等，贯穿了客户智能化生产的全生命周期，有效提升客户黏性。

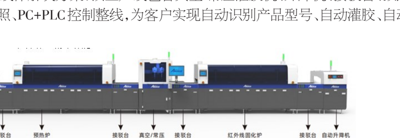
（5）智能生产解决方案

公司除了销售单一整机设备外，还致力于为客户提供覆盖PCBA加工、终端组装等多环节的智能生产整线解决方案，可广泛应用于消费电子、汽车电子、新能源、半导体、智能家居及医疗等多行业领域的电子产品智能生产制造。

①点胶线体解决方案：该生产线以304不锈钢设计的高速点胶机系列为主体，配有自动上下料机、接驳台、UV检测台等设备，可配置单双轨&单双阀、微量天平、激光测高等，多种功能灵活搭配升级来实现不同的点胶工艺。

②PCBA板涂覆解决方案：该生产线以iCoat系列涂覆机为主体，还配置了IR固化炉，双面飞拍AOI涂覆检测机，翻板机，升降机，接驳台。实现了一站式的PCBA涂覆、固化、AOI检测，亦可配置双机双炉等定制化方案，最大程度保证加工工艺稳定性。

③在线真空/常压灌胶线体解决方案：该生产线包含真空/常压灌胶机、升降机、接驳台、预热炉、固化炉、全景/3D相机视觉拍照、PC+PLC控制整线，为客户实现自动识别产品型号、自动灌胶、自动烘干、工装自动回流等功能。



④ADA智能平台多模组整线方案：ADA智能平台可以单机生产模式，亦可以多机连线的生产模式。根据产品的工艺流程、产能需求与排线平衡，公司可以为客户自定义布局模组，采用多单元和各种工艺模块的组合实现量产目的，换线只需更换模块即可，无需移动设备。ADA智能平台不同工作站选配不同工艺模块，或与人工位或与其他专用设备混搭结合使用，能实现产线的无限扩展，为快速搭建大型生产线提供一站式智能制造服务。通过搭载LMES系统实现离线排产、离线编程、离线生产等，使其有效解决制造业设备通用性低、故障排除时间长、操作技术门槛高、换线转产不灵活的四大行业痛点。

2.2 主要经营模式

1、盈利模式

公司已建立覆盖智能制造装备研发、生产和销售为一体的完整业务模式，基于产品的前期研发投入、生产成本等因素制定产品价格，并通过向客户销售智能制造装备、提供配件及技术服务实现盈利。

2、采购模式

公司主要根据生产计划、研发需求以及销售订单相关的产品BOM清单，按需下达采购订单。此外，公司亦会根据与客户沟通的预测订单安排批量生产，并依此提前采购一部分通用物料，以满足生产排产的领料需求。公司直接采购的物料以标准化零配件为主，属于原材料采购，直接面向供应商进行采购。另外，公司还会委托部分供应商进行部分五金件、机加件、电气件的简单加工，即外协加工模式，公司向其支付加工费。

3、生产模式

公司以自主生产为主，对少部分附加值较低的钣金件、机加件和电气件的简单加工以委托加工方式进行。在生产组织方面，公司主要为订单导向型，生产计划主要根据销售订单及客户告知的订单预测情况执行，公司会通过与客户深入沟通，充分了解主要客户当年度的预计产能需求，并根据客户生产计划着手开始进行材料采购、制定生产计划，确保生产计划均衡分配、按时完成、准时发货；在生产工艺方面，公司产品在标准设备的基础平台上，通过加载工艺模块、变更关键核心零部件或优化运动算法等方式，即可满足客户多样化的工艺需求。当客户有特殊的工艺需求时，公司亦会根据客户需求定制化生产。

4、研发模式

公司建立了研究院+研发中心+应用研发三层研发体系。其中，研究院定位为公司前沿技术策源地与核心部件研发中心，主攻驱控技术与工业软件两大方向，为公司全业务线提供底层技术支撑；研发中心定位为公司通用产品迭代与技术平台中心，聚焦公司通用型智能装备、软件平台的优化升级与标准化建设；应用研发定位为公司客户化解决方案与项目化交付中心，以客户需求与项目落地为核心导向，紧密对接下游行业应用场景与客户个性化需求。

5、销售模式

公司产品以直接销售为主。公司依托深厚的技术积累和快速交付等优势，实现了与全球电子信息产业头部客户及其EMS厂商的互赖互信，建立了长效而稳定的合作机制。公司直接与客户或其EMS厂商签订订单并直接发货，为其提供相关的智能制造装备及解决方案、零配件和技术服务。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1）公司所属行业及确定依据

公司主营业务为部品研发、流体控制设备、等离子设备、固化及智能组装设备等智能制造装备的研发、生产、销售及技术服务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754－2017）》，属于"C3569其他电子专用设备制造"；根据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），属于"2.1智能制造装备产业－3569其他电子专用设备制造"；根据国家发展改革委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，公司产品属于"2.1.4智能加工装备"中的"智能基础制造装备"。

2）行业发展阶段

公司广义的行业分类属于智能装备制造业，生产的流体控制设备属于更为细分的电子专用设备制造行业。当前，我国智能装备制造行业正处于从单机自动化、产线数字化向智能化跃迁的关键期，上游核心零部件的技术突破与国产替代进程加速，软件、芯片的迭代升级，夯实了技术底座，有效降低了生产成本；下游新能源、汽车、3C等重点行业需求升级，带来了产业规模与应用水平的快速提升，国家统计局发布的《2025年国民经济和社会发展统计公报》显示，2025年我国新质生产力稳步成长，规模以上工业中装备制造业增加值同比增长9.2%。装备制造业作为新质生产力的核心承载领域，在"人工智能+制造"等政策的多重驱动下，行业逐渐呈现AI深度融合、自主可控强化、绿色低碳转型、规模化推广应用的发展特征，新型智能制造体系建设正加速推进。

尽管近年来在政策引导、技术创新与产业需求等多重因素驱动下，智能装备制造行业实现了稳步增长，但核心技术受制于人、产业链协同不足、专业人才缺口大以及企业智能化转型成本高、资源利用率低等短板仍待突破。

3）行业基本特点

①下游行业的高增长推动可持续发展

智能装备制造业的下游应用领域非常广泛，主要包括消费电子、AI服务器、新能源、汽车制造、半导体、医疗器械、家居等行业。当前消费电子行业整体呈现总量平稳、结构创新升级的发展态势，产品的快速迭代加快了生产设备更新，拉动智能装备制造业向高精度、高柔性、智能化方向升级。与此同时，我国AI服务器、新能源汽车、储能、半导体市场正处于快速发展阶段，市场需求旺盛，产业规模持续扩张，为智能制造装备市场注入强劲增长动能，行业应用空间广阔、发展前景持续向好。

②关键核心零部件技术攻坚取得积极进展，自主化与高端化并行突破

核心零部件的结构设计与精密加工能力始终是支撑智能装备升级的关键基础。我国高端制造业因发展历程较短，在上游技术积累和产业链配套方面仍存短板，部分高端领域的关键材料、工艺及核心部件与国际先进水平存在代际差距，对外依存度较高。

在此背景下，2025年中央经济工作会议强调加强关键核心技术攻关。"十五五"规划纲要进一步聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节，提出采取超常规措施，全链条推动工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。工信部等六部门印发的《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》明确实施产业基础再造工程，围绕重大技术装备和重点领域整机配套需求，发展高可靠、高强度、高品质基础零部件。国家标准委与工信部联合印发《工业母机高质量标准体系建设方案》，加快高端工业母机、高档数控系统、高性能功能部件、关键核心零部件等标准研制。基于上述政策引领，各地围绕制造业重点产业链持续深化自主创新，促进关键核心零部件技术积累，产业链和供应链的自主可控水平稳步提升，智能装备产业结构持续优化升级。

③高端制造领域设备国产化进程加速，智能制造向标准化与高质量升级

在全球制造业数字化、智能化转型的浪潮之下，智能装备作为新一代信息技术与先进制造技术深度融合的产物，成为各国争夺的核心赛道，也是我国国民经济的重要支柱产业。近年来，随着我国制造业转型升级步伐加快，高端装备制造自主创新成果显著，国产化进程明显提速，自主供给能力持续增强，工业机器人、数控机床、光伏锂电装备、半导体设备等关键领域国产化率逐年提升。目前在高端制造领域，国内已培育出具备全链条创新能力的智能装备企业集群，构建起产学研协同的技术创新体系，在核心算法、精密传动等关键领域实现自主突破，部分高端产品技术指标达到国际先进水平。尽管部分高端零部件、高端芯片、关键工艺环节等仍存在短板，但整体来看，国产高端设备市场份额持续扩大，为产业链自主可控与新质生产力发展提供坚实支撑。

当前行业核心任务正从规模扩张转向质量提升与标准化建设。2025年8月，工业和信息化部等八部门联合印发《机械工业数字化转型实施方案（2025—2030年）》（工信部联通装〔2025〕152号），明确构建"两步走"发展路径：到2027年实现智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%、建成不少于200家卓越级智能工厂；到2030年，机械工业规上企业基本完成一轮数字化改造，重点企业的产业链供应链上下游实现数据互联、共享协同。该方案以智能制造为主攻方向，通过构建产学研协同创新体系，强化标准引领与技术融合，推动核心部件国产化率提升，并依托智能工厂梯度培育降低中小企业转型成本，进一步巩固国产替代成果，为行业从"单点突破"迈向"系统化生态重构"提供制度保障。

4）主要技术门槛

①技术壁垒

智能制造装备行业属于技术密集型、资金密集型、人才密集型行业，其发展融合了多学科技术体系且更新迭代快，是下游终端制造业突破工艺和产能限制的关键因素，因此企业需要在包括先进制造、光学成像、机械系统、电气控制、信息技术、人工智能等领域进行大量技术积累，持续开展技术攻关，储备行业应用经验，深度把握下游行业技术变革趋势，才能够在行业中立足并建立竞争优势。

②应用领域的行业经验壁垒

面对市场不断变化的终端产品，客户对智能制造装备的稳定性、精密性、安全性、可靠性以及供应商的售后服务和技术支持能力有较高的要求。智能制造装备企业需要根据客户行业特点、行业规范、货品类型、功能需求、相关配套工程、客户预算等众多因素进行解决方案设计，以便更好地服务客户，因此下游客户更青睐于拥有较强的研发设计能力、丰富的项目实施经验、专业化的项目管理团队，并能够提供长期售后服务的设备制造商，这才是行业的客观需求和长期发展趋势。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司于2010年推出经广东省电子学会SMT专业委员会认证的"国内首款全自动多功能高速点胶机"，是国内较早专业从事流体控制设备研发和生产的企业，此后不断推出各类智能制造装备，逐步加深在SMT电子装联、FATP后段组装、TP触摸屏涂覆等工序的应用。

在业务方面，公司奠定了以流体控制应用为核心产品基础，同步覆盖点胶、涂覆、AOI检测、等离子清洗、固化、智能组装、柔性生产、仓储物流等多道工序环节的多元化产品布局，目前已获得国家级专精特新"小巨人"企业、国家级高新技术企业、省级企业技术中心、省级知识产权示范企业、国家知识产权优势企业、"广东省制造业500强"等多项省级与国家级资质荣誉称号，同时公司还获批设立了广东省博士工作站、博士后创新实践基地。

在技术方面，公司基于多年对基础技术的积累，围绕智能制造装备构建了核心零部件研发、运动算法及整机结构设计三大核心技术体系，深度应用于点胶机、涂覆机、ADA智能平台等核心产品，形成显著技术优势。同时，公司多个产品获得多项殊荣，包括中国著名品牌（高速点胶机、智能涂覆机、等离子清洗机、ADA智能组装设备系列）、广东省名优高新技术产品（全自动高速PCB封装点胶机）、广东省省级制造业单项冠军企业（非接触喷射阀高速智能点胶机）等，在业内大客户及其产业链中具有较高的知名度和美誉度。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2025年底，工业和信息化部等八部门印发《"人工智能+制造"专项行动实施意见》，明确提出要加快推进人工智能技术在制造业融合应用，赋能原材料、装备制造、消费品、电子信息等制造业相关重点行业。过去一年，我国工业经济总体保持平稳增长，科技创新与产业创新深度融合、协同发力，"人工智能+"在工业领域加速渗透应用，新技术、新产品、新应用场景加快培育壮大。在国家"两重""两新"等一系列稳增长政策措施支持下，行业经济运行稳中有进，高质量发展取得积极成效。根据国家统计局数据，2025年1-12月，我国专用设备制造业增加值同比增长6.4%，营业收入超3.9万亿元。

展望未来，随着新技术、新赛道的加速涌现，电子信息制造业作为新质生产力的核心载体，将持续向高端化、智能化、绿色化方向深化推进。当前行业虽面临地缘冲突、国际竞争与技术壁垒等挑战，但在政策引导、市场需求释放与自主创新驱动的多重支撑下，智能制造将进一步赋能制造业转型升级，为经济高质量发展提供坚实支撑，中国也将在全球智能制造装备产业格局中占据更加重要的地位。

1）新技术

新技术迭代与升级，推动下游产品的迭代升级，也推动智能装备在精度、柔性、智能化水平上持续突破。随着AI大规模普及，折叠屏、轻薄化与空间计算终端快速迭代，消费电子产品持续向高集成、微型化升级，带动精密贴装、精细加工、AI视觉检测及柔性自动化组装装备需求提升。新能源汽车领域，800V高压平台、碳化硅电驱、一体化压铸及新型电池技术的广泛应用，拉动专用装备的持续放量。半导体行业，Chiplet异构集成、3D先进封装、HBM高带宽存储等新技术带动芯片结构与制造工艺革新，进而带来封装、键合、量检测等关键设备的需求爆发。AI服务器方面，随着高密度算力、液冷散热、高压供电的升级，催生高多层PCB制程、液冷系统装配、高速信号测试等新型高端装备的需求。

2）新产业

①AI应用和终端

当前，新一代智能终端已实现"人工智能+终端"到"人工智能终端"的历史性跨越，AI不再是终端附加功能，而是深度融入芯片、操作系统、感知交互与连接架构的智能内核。"十五五"规划纲要提出要开发提效型、陪伴型等智能原生应用，发展人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端，探索智能产品新形态。据中国信息通信研究院发布的《新一代智能终端蓝皮书》显示，2025年全球AI手机渗透率达34%，智能助理级（L3）服务普及，辅助通话、影像处理、自动化任务等能力日趋成熟；AI PC全年出货量突破1亿台，渗透率超40%，端侧算力显著提升，智能体可支撑全流程办公自动化；AI眼镜、手表、耳机等可穿戴设备向多模态交互、健康监测、实时翻译等高阶功能演进。

以AI手机、AI PC为突破口，AI终端正加速向全品类渗透，在突破关键技术、构建可信生态的同时，带动端侧智能硬件与配套精密制造产业的加速发展。

②新能源汽车及新兴氢能

目前，全球新能源汽车市场正处于从导入期向成长期过渡的阶段，研究机构EV Tank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书》显示，2025年全球新能源汽车销量达到2354.2万辆，同比增长29.1%，这是技术迭代、政策引导与消费认知升级的共同作用。近年来，新能源汽车行业正经历电动化筑基、智能化突破、网联化延伸的三重变革，新技术的持续突破，不仅显著提升了产品性能，还极大地推动了产业的规模化发展和产业链的不断完善，更为装备制造业带来了广阔发展机遇。

对于氢能行业，"十五五"规划纲要提出要培育壮大新兴产业和未来产业，提升可再生能源制氢装备水平，加快攻关验证经济安全的规模化氢储运技术，优化布局氢能基础设施，推动绿氢产业链向绿色氨醇、可持续航空燃料延伸，拓展氢能在交通、电力、工业等领域应用。这一系列发展部署，为装备制造业开辟了全新赛道，带来了多元化市场机会。

③AI服务器

近年来，随着生成式AI、大模型商业化落地加速，算力需求迎来指数级增长，AI服务器作为算力基础设施的核心载体，市场需求持续爆发，也使得整机ODM/OEM厂商订单高增。精密加工、液冷系统集成、自动化装配、AI视觉检测、高速互联测试等环节的智能装备需求持续走高，为装备制造业带来发展机遇。

当前，AI服务器代工目前仍处于人工组装为主的早期，但未来随着服务器复杂度的提升，自动化的需求也在逐步显现。一方面，液冷正逐步替代风冷成为AI服务器的主流散热方式，液冷方案下AI服务器整机重量显著增加，组装难度随之提高，催生了对自动化组装设备的需求。另一方面，全球AI服务器出货量持续高速增长，劳动密集型的生产模式在可扩展性上存在瓶颈。根据Trendforce，预计到2026年全球人工智能服务器出货量预计将同比增长超过28%。庞大的市场需求下，依赖人工的生产模式在可拓展性上存在瓶颈，而自动化产线可以通过增加设备快速复制和拓展产能，同时显著降低人力成本，可以匹配AI服务器组装的成本与规模化难题。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	234,705.66	227,912.40	2.98	215,464.79
归属于上市公司股东的净资产	182,405.11	189,901.63	-3.95	190,192.42
营业收入	69,836.35	71,112.50	-1.79	47,240.84
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	68,988.52	71,095.57	-2.96	47,169.81
利润总额	-14,710.37	-5,651.39	不适用	1,946.87
归属于上市公司股东的净利润	-10,808.88	-3,074.52	不适用	2,916.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,003.09	-3,455.23	不适用	1,320.57
经营活动产生的现金流量净额	-662.19	-21,724.10	不适用	6,144.85
加权平均净资产收益率(%)	-5.81	-1.63	不适用	1.53
基本每股收益（元／股）	-1.32	-0.38	不适用	0.36
稀释每股收益（元／股）	-1.32	-0.38	不适用	0.36
研发投入占营业收入的比例(%)	20.59	19.34	增加1.25个百分点	21.22

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	141,918,555.12	200,674,349.69	158,545,462.11	197,225,119.93
归属于上市公司股东的净利润	-20,177,341.42	-38,266,466.31	-38,529,860.65	-11,115,162.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,684,859.04	-19,635,561.53	-45,069,569.59	-13,640,935.88
经营活动产生的现金流量净额	14,815,603.96	-33,674,035.31	-52,403,673.45	64,640,223.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,802
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,563
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量	股东性质
东莞市盛晟实业投资有限公司		42,628,800	51.91		无		境内非国有法人
东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）	-2,250,315	6,750,945	8.22		无		境内非国有法人
刘飞		4,800,000	5.84		无		境内自然人
何玉姣		2,549,940	3.10		无		境内自然人
中金公司－杭州银行－中金安达智能1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-452,016	1,099,929	1.34		无		境内非国有法人
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	880,095	886,782	1.08		无		境外法人
高盛公司有限责任公司	613,648	622,804	0.76		无		境外法人
李雯佳	318,400	600,000	0.73		无		境内自然人
杨明辉		600,000	0.73	360,000	无		境内自然人
罗纾沂	594,631	594,631	0.72		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘飞、何玉姣系夫妻关系，两人是公司实际控制人，共同控制东莞市盛晟实业投资有限公司，东莞市盛晟实业投资有限公司系公司的控股股东；东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）系公司的员工持股平台，刘飞担任执行事务合伙人。中金安达智能1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划是公司员工参与战略配售的平台。除此之外，公司未知其他前十名股东间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

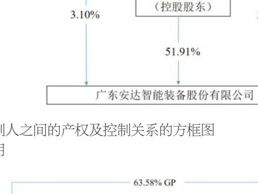
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

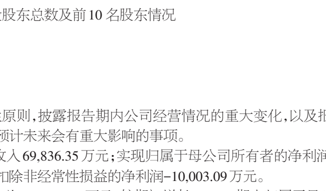
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，公司实现营业收入69,836.35万元；实现归属于母公司所有者的净利润-10,808.88万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-10,003.09万元。

2025年期末，公司总资产为234,705.66万元，较期初增长2.98%；期末归属于母公司的股东所有者权益为182,405.11万元，较期初下降3.95%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688125　　证券简称：安达智能　　公告编号：2026-016

广东安达智能装备股份有限公司 2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案的内容

（一）利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-10,808.88万元，其中，2025年度母公司实现净利润-7,772.03万元；截至2025年12月31日，母公司期末累计未分配利润为9,809.99万元。

经公司第二届董事会第十八次会议决议，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

截至本公告披露日，公司已上市满三个完整会计年度，2025年度净利润为负值，公司本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2025年度未实现盈利，同时考虑公司持续、稳定的发展需求，为了更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2025年度利润分配预案符合上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定。

三、公司履行的决策程序

2026年4月22日，公司召开第二届董事会第十八次会议，全票审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该议案提交至公司股东会审议。本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

公司本次利润分配预案结合了公司目前的发展阶段、经营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2026年4月24日